

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年9月19日
【会社名】	株式会社 東芝
【英訳名】	TOSHIBA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 綱川 智
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03-3457-4511
【事務連絡者氏名】	法務部法務第一担当グループ長 篠崎 俊司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目1番1号
【電話番号】	03-3457-2148
【事務連絡者氏名】	法務部法務第一担当グループ長 篠崎 俊司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社の連結子会社である東芝アメリカ電子部品社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名 称 東芝アメリカ電子部品社(以下「TAEC」)  
住 所 9740 Irvine Blvd., Suite D700, Irvine, CA 92618, USA  
代表者 佐野 修久 President & CEO

(2) 当該訴訟の提起があった年月日等

訴訟提起があった日 2017年8月14日  
TAECに訴状送達があった日 2017年8月18日

(3) 当該訴訟を提起した者の名称及び住所

名 称 : Anza Technology, Inc (以下「原告」)  
住 所 : 米国カリフォルニア州

(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

原告はTAECがESD対策(\*1)を施したフリップチップボンディング装置(\*2)とその使用方法に関する特許(米国特許第7,389,905号)を侵害していると主張し、TAECに対し、特許権侵害に基づく損害賠償等(弁護士費用、利息を含む)を求める訴訟を提起しました。なお、TAECが受領した訴状には請求額は明示されておりません。

\*1：静電放電を防止するための対策。

\*2：チップ表面に作ったバンプという突起状の電極を使ってチップを実装するための装置

以 上